

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和1年11月21日(2019.11.21)

【公開番号】特開2017-92464(P2017-92464A)

【公開日】平成29年5月25日(2017.5.25)

【年通号数】公開・登録公報2017-019

【出願番号】特願2016-214727(P2016-214727)

【国際特許分類】

H 01 L 21/60 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/60 301D

【手続補正書】

【提出日】令和1年10月11日(2019.10.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0004】

特定のタイプの半導体パッケージでは、種々の半導体ダイが「積み重ねられたダイ」の構成で配置される。そのようなパッケージでは、それらのダイのうち1若しくはそれ以上が他のダイ(またはスペーサー、基板など)から張り出す場合がある。図1は、そのようなパッケージを例示したものである。図1において、下側の半導体ダイ102は、基板100により支持されている(ここで、ワイヤーループ108が、ダイ102上のボンディング位置と、基板100上の別のボンディング位置との相互接続をもたらしている)。スペーサー104は、下側の半導体ダイ102と上側の半導体ダイ106間に配置される。上側の半導体ダイ106は、スペーサー104および下側の半導体ダイ102から張り出し、当該スペーサー104および半導体ダイ102に支持されていない部分を含む。そのため、上側の半導体ダイ106は「オーバーハングダイ」(張り出したダイ)と呼ばれることがある。

この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある。

(先行技術文献)

(特許文献)

(特許文献1) 米国特許第7,762,449号明細書

(特許文献2) 米国特許第7,699,209号明細書

(特許文献3) 米国特許第5,566,876号明細書

(特許文献4) 米国特許第8,302,840号明細書

(特許文献5) 米国特許出願公開第2012/0074206号明細書

(特許文献6) 中国特許出願公開第101740427号明細書

(特許文献7) 特開平07-183321号公報

(特許文献8) 特開2007-180349号公報

(非特許文献)

(非特許文献1) Search Report issued by China National Intellectual Property Administration in connection with related Chinese Patent Application No. 201610959217.4.